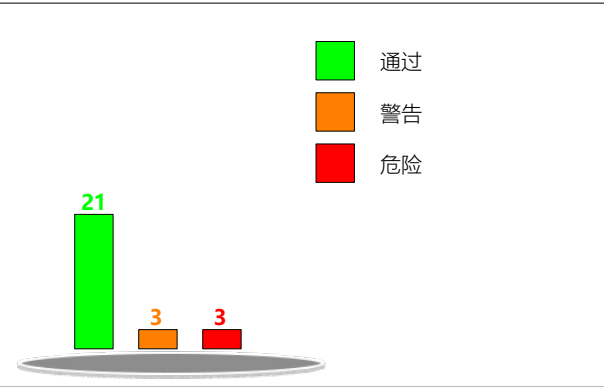


# HQDFM Design for Manufacture(DFM) Report

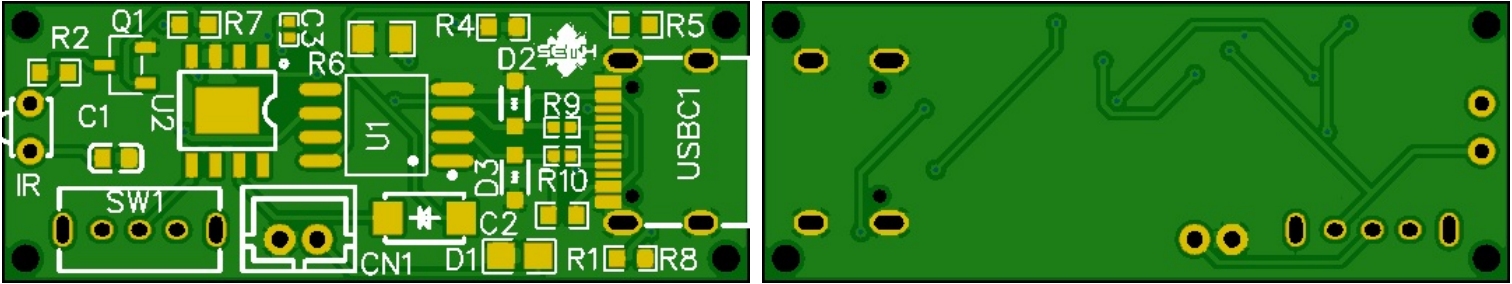
文件名: 0000A712887\_1

2026-01-29      Layer num: 2      PCB板厚: 1.60      数量: 5      尺寸: 40.00\*15.00 mm

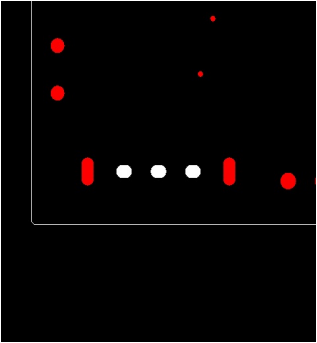



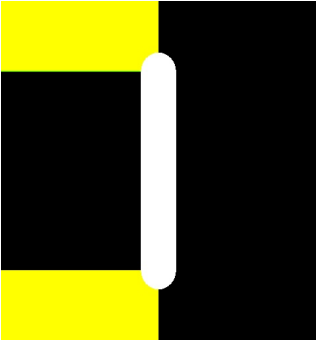
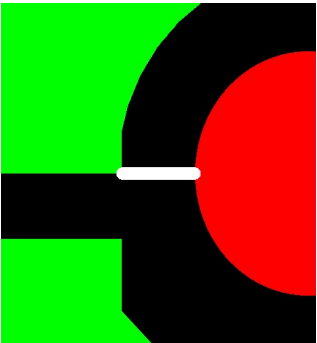
基础参数	线宽/线距	10.00/9.00mil
	锣长分析	196.8987米/m²
	沉金面积	25.05%
	飞针点数	75
	利用率	81.0713%

温馨提示: 文件尺寸小, 会影响贴片组装工序, 建议尺寸大于7\*7cm, 优化尺寸可通过加工艺边或增加拼版的方式。



类型	检查项	检查子项数	结果
PCB_线路分析	最小线宽	1	通过 2
	最小间距	3	通过 313
	SMD间距	2	通过 8 ,不通过 22
	最小焊盘	3	通过 16
	网格铺铜	2	通过
	孔环大小	2	通过 2
	孔到线	5	通过 59 ,不通过 2
	电气信号	4	不通过 2
	板边距离	2	通过 10 ,不通过 13
	孔上焊盘	4	通过
	开短路	1	不通过
PCB_钻孔分析	钻孔孔径	8	通过 42 ,不通过 6
	孔密度	1	通过
	钻孔孔径	8	通过 42 ,不通过 6
	孔到孔	4	通过
	孔到板边	4	通过 4
	孔密度	1	通过
	特殊孔	2	通过
PCB_阻焊分析	阻焊间距	2	通过 2
	阻焊少开窗	1	通过
PCB_字符分析	丝印分析	1	通过 2
ASS_光学点分析	Mark点	1	通过

序号	检查项	规则	分析值	问题描述	问题图片	Coordinate	数量	等级
1	钻孔孔径_槽长宽比	1.5,2,2	正常	业内绝大多数工厂的最低极限为1.5倍，小于1.5倍则生产的难度更大、效率更低、成本更高；您的“最短槽”长宽比为1.29倍，建议“最短槽”长宽比 > 2倍，或改为圆孔		14.35,83.82	8	危险
2	SMD间距_Smd焊盘间距	6,8,10	7.86 mil	您的“SMD焊盘”最小间距为7.86mil会影响生产效率、品质良率，而且存在连锡隐患，建议“SMD焊盘”最小间距 ≥ 8 mil		40.09,89.52	15	警告

3	SMD间距_焊盘间距	6,8,10	7.86 mil	您的“SMD焊盘”最小间距为7.86mil会影响生产效率、品质良率，而且存在连锡隐患，建议“SMD焊盘”最小间距 $\geq 8$ mil		40.09,89.52	15	警告
4	孔到线_NPTH到铜	8,10,12	9.59 mil	mil, 建议“NPTH到铜”最小 $\geq 12$ mil9.59mil建议“NPTH到板边”改为 $\geq 10$ mil		40.21,91.42	10	警告

5	电气信号_锐角	7,7,7	异常	你的设计中存在锐角连接方式，会影响产品信号完整性，建议将锐角位置调整为钝角连接方式的圆弧		9.37,92.54	2	警告
6	板边距离_铜到板边	8,15,20	5.19 mil	业内绝大多数工厂的锣边极限为8mil，小于该极限值，有露铜甚至断线的隐患；您的“导线/焊盘/覆铜到板边”最小间距为5.19mil，建议≥10mil；如是V割边，建议≥15mil，具体极限值与板厚、V刀角度有关，规则请查看“DFM文档”		46.81,82.92	7	危险